

天津金海通半导体设备股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文核准，本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,500.00 万股，其中网上发行 1,500.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行价格为人民币 58.58 元/股。本次网上发行中签率为 0.01618400%。

本次发行的发行流程、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、投资者应根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 22 日（T+2 日）终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出，即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配通知。

根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人天津金海通半导体设备股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于 2023 年 2 月 21 日（T+1 日）上午在浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室会议室主持了天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	7938
末“5”位数	26636, 46636, 66636, 86636, 06636, 23670
末“6”位数	054195
末“7”位数	2573230, 3823230, 5073230, 6323230, 7573230, 8823230, 1323230, 0073230
末“8”位数	31545087, 86607289, 18083544

凡参与网上发行申购天津金海通半导体设备股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 15,000 个，每个中签号码只能认购 1,000 股天津金海通半导体设备股份有限公司 A 股股票。

发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023 年 2 月 22 日

(本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页)

发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司



2013年2月21日

（本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上
定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

